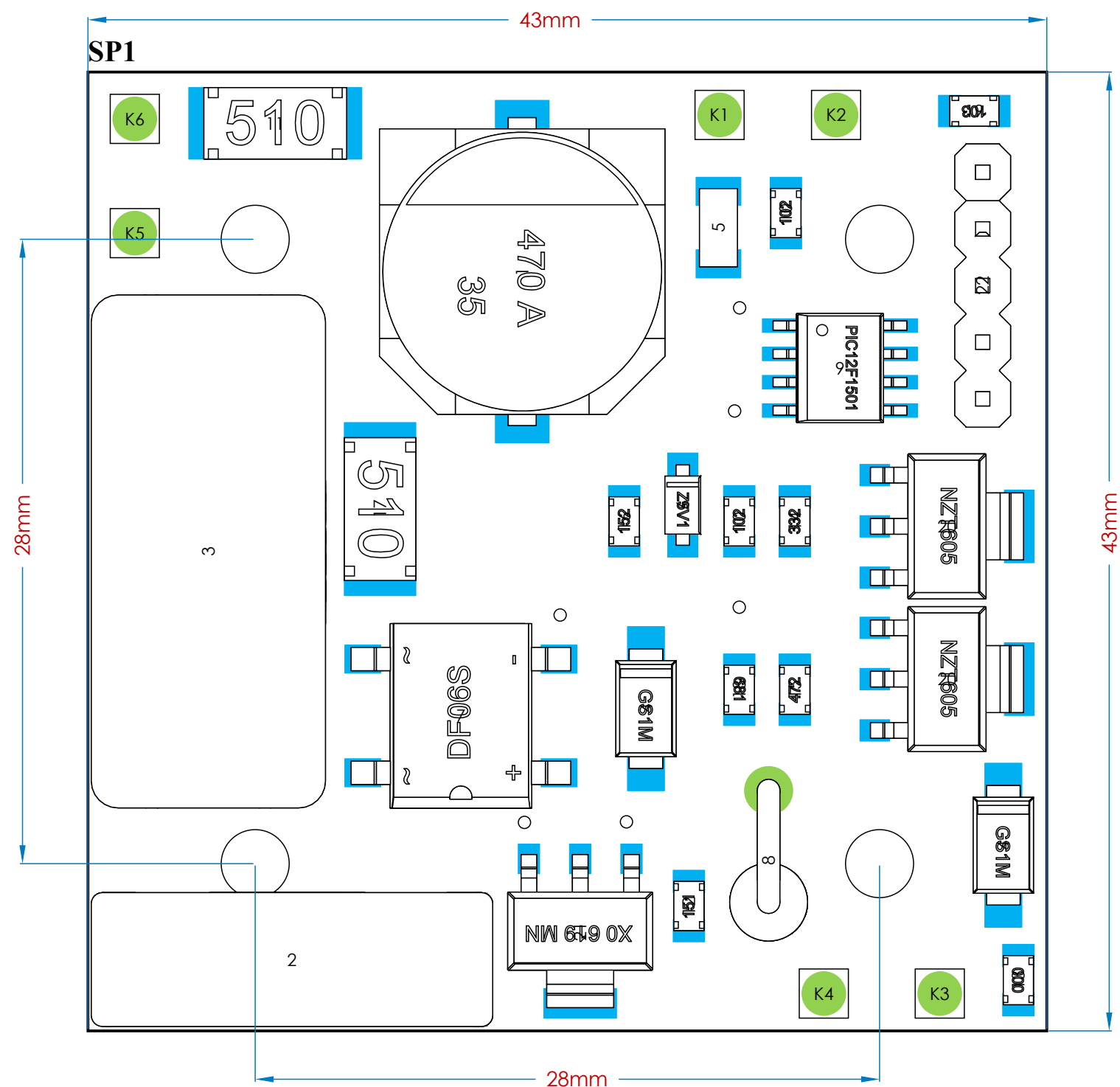


Boards

{A5B7L.XXXXXX.XXXCB}



Отверстия

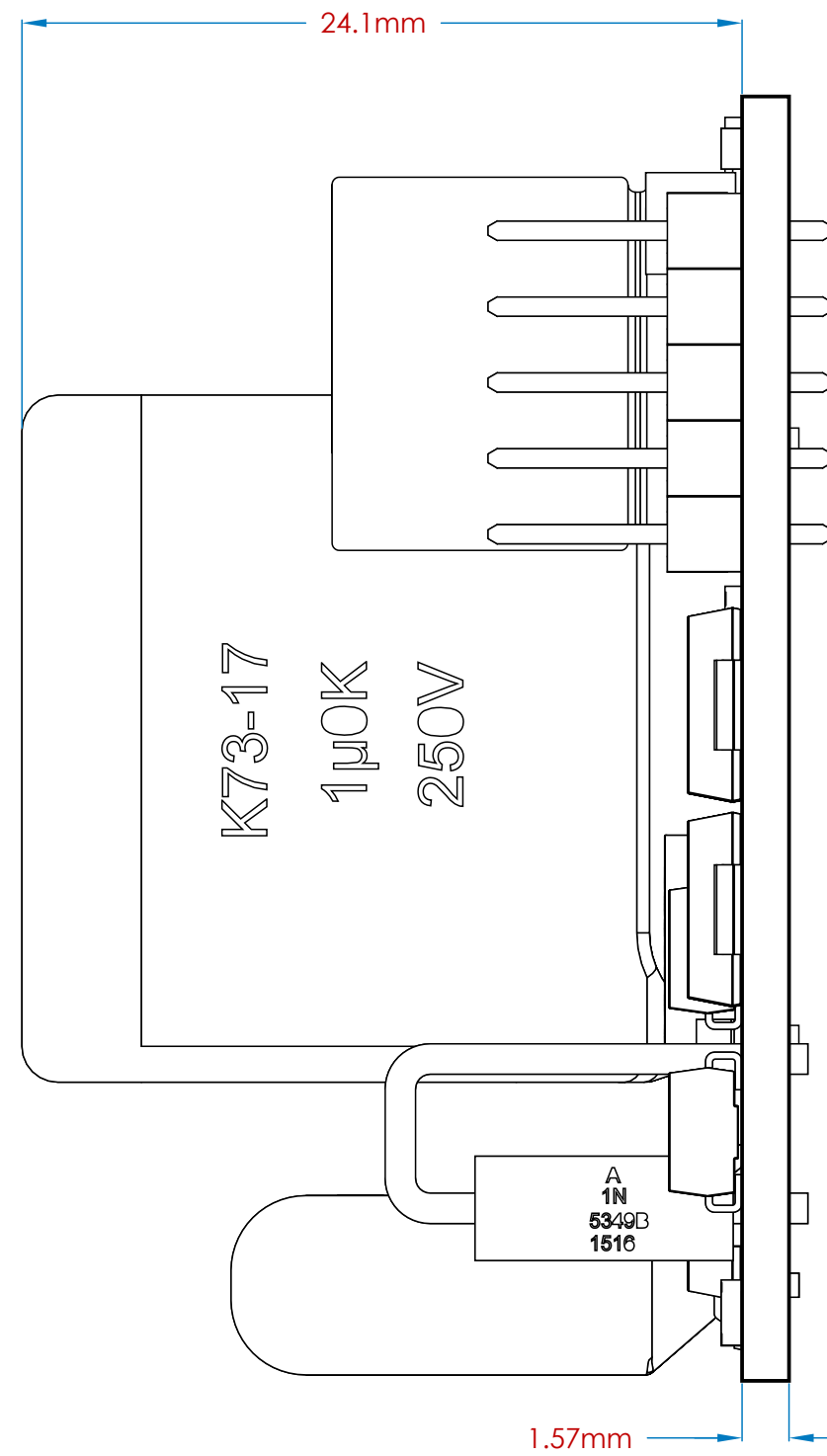
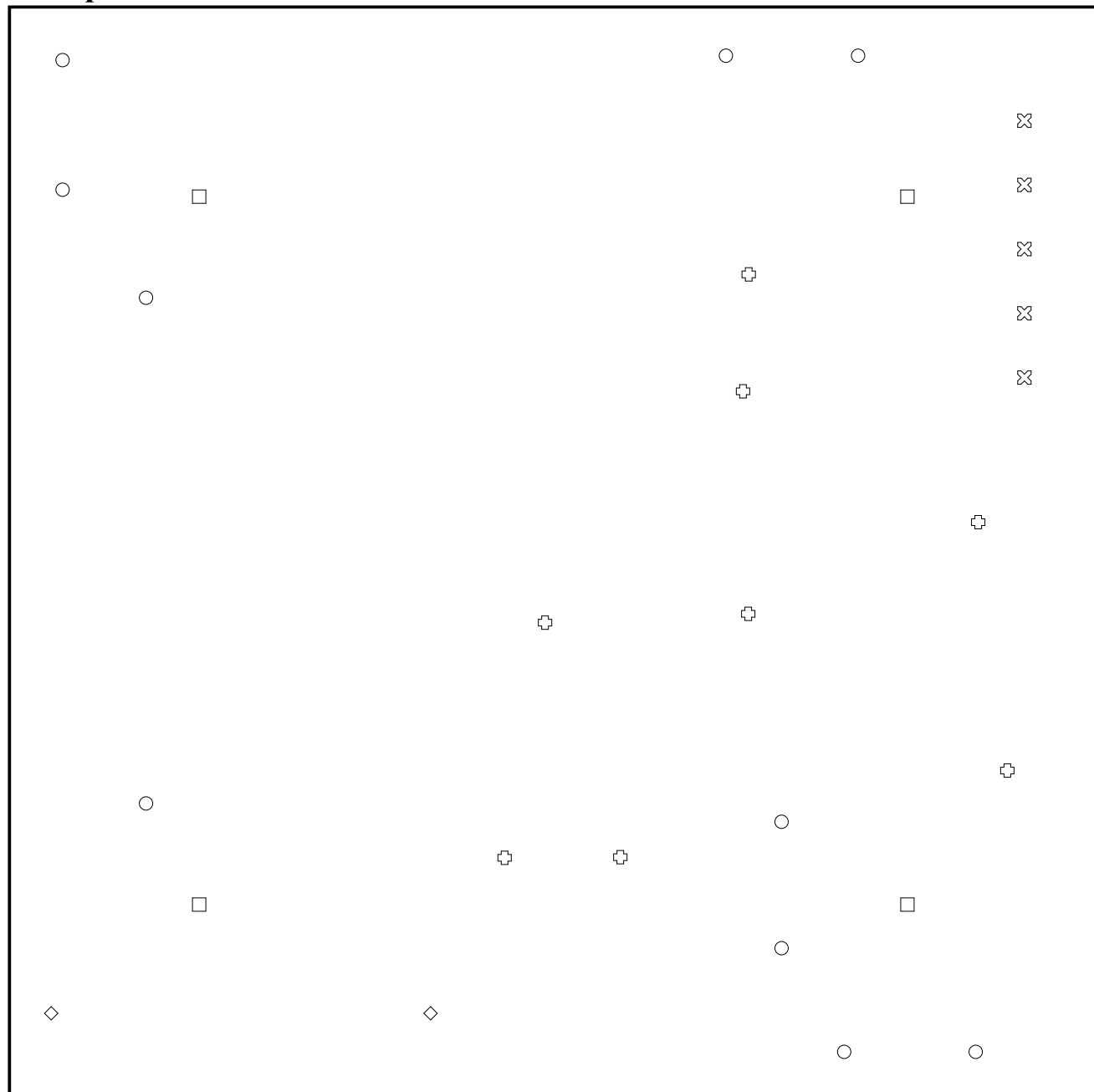







Таблица отверстий

Symbol	Count	Hole Size	Plated	Hole Type	Via / Pad	Drill Layer Pair
	8	0.6mm	Plated	Round	Via	Top Layer - Bottom Layer
	5	1.02mm	Plated	Round	Pad	Top Layer - Bottom Layer
	2	1.1mm	Plated	Round	Pad	Top Layer - Bottom Layer
	10	1.2mm	Plated	Round	Pad	Top Layer - Bottom Layer
	4	3.1mm	Plated	Round	Pad	Top Layer - Bottom Layer
	29 Total					

Перечень элементов

Item	Designator	Comment	Quantity	Footprint
1	C1	470uF x 35V	1	MALSEC V00AH347FARK_470.0x35V_CAPAE138128X140N
2	C2	0.1mkFx400V	1	K73-17_0.1mkFx400V
3	C3	1.0mkFx250V	1	K73-17_1.0mkFx250V
4	D1, D4	GS1M	2	GS1M_SMS/DO-214AC
5	D2	GL34J	1	GL34J_DO_213AA
6	D3	MMSZ5231B	1	MMSZ5231B_SOD-123F_L360X115-2N
7	D5	DF06S	1	DF06S_SOIC127P1010X330-4N
8	D6	1N5349B	1	1N5349B_CASE 017AA
9	IC1	PIC12F1501T-I/SN	1	PIC12F1501T-I/SN_SOIC127P600X175-8N
10	R1, R6	1.0 kOm	2	R0805-2012_102
11	R10	51 Om	1	R2512-6332_510
12	R11	150 Om	1	R0805-2012_151
13	R2	0 Om	1	R0805-2012_000
14	R3	3.3 kOm	1	R0805-2012_332
15	R4	4.7 kOm	1	R0805-2012_472
16	R5	1.5 kOm	1	R0805-2012_152
17	R7	510 kOm	1	R2512-6332_510
18	R8	680 Om	1	R0805-2012_681
19	R9	10 kOm	1	R0805-2012_103
20	T1, T2	NZT605	2	NZT605_SOT-223
21	VS1	X00619MN5AL2	1	X00619MN5AL2_SOT-223
22	XP1	PLS-05	1	PLS-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ледов К.А.			
Проверил					
Т. контр.					
Н. контр.					
Уте.		Исмагилевич И.Ш			

{Индекс заказчика}

{АБВГ.ХХХХХХ.ХХХСБ}

SP1

Сборочный чертёж

Лист.				Масса	Масштаб
					1:1
Лист 1				Листов 1	